(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-86746

(43)公開日 平成7年(1995)3月31日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	广内整理番号	FI	技術表示箇所
H05K	3/46	Н	6921 - 4E		汉州农小面7]
B 2 8 B	11/02				
B 3 2 B	18/00	D	7148-4F		

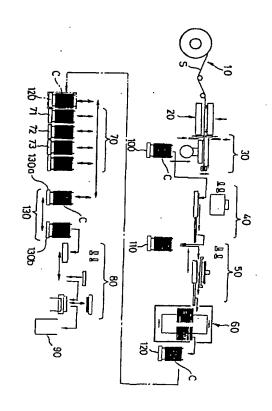
		審査請求 未請求 請求項の数8 FD (全 10 頁)
(21)出廢番号	特顯平5-251082	(71) 出願人 000003067
(22)出願日	平成5年(1993)9月13日	ディーディーケイ株式会社 東京都中央区日本橋1丁目13番1号
		(72)発明者 吉田 政幸
		東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ
		ーディーケイ株式会社内
		(72)発明者 宮内 栄作
		東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ
		ーディーケイ株式会社内
		(72)発明者 渡辺 源一
		東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ
		ーディーケイ株式会社内
		(74)代理人 弁理士 竹下 和夫
		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 セラミック多層基板の製造方法及び装置

(57) 【要約】

【目的】 セラミックグリーンシートをセラミックカードとして裁断し、スルーホール加工,電極印刷,電極乾燥,多層接合工程を含む各工程に能率よく連続送りし、また、異品種の製品を製造するのに容易に対応できて設備全体の小型化も図る。

【構成】 セラミックグリーンカードCを所定の加工処理後にカセット台100,110,120,130に順次積層載置し、次工程には複数枚積層されたカセット台から順次に取出し転送し、全工程をカセット台からカセット台で連続させてセラミックグリーンカードを転送送りする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 スルーホール加工,電極印刷,電極乾燥,多層接合工程を含む各工程を経て、セラミックグリーンシートからセラミック多層基板を製造するのに適用されるセラミック多層基板の製造方法において、セラミックグリーンシートを所定な大きさのセラミックグリーンカードに裁断し、そのセラミックグリーンカードをあせったは順次に積層載置し、次工程にはセラミックグリーンカードを複数枚積層載置されたカセット台から順次に取出し転送し、全工程をカセット台からカセット台で連続させてセラミックグリーンカードを転送送りするようにしたことを特徴とするセラミック多層基板の製造方法。

【請求項2】 樹脂フィルムをベースフィルムとして形成されたセラミックグリーンシートからベースフィルム付きのままセラミックグリーンカードを裁断し、以後の工程をベースフィルム付きのまま転送処理し、多層接合時にベースフィルムをセラミックグリーンカードから剥離するようにしたことを特徴とする請求項1のセラミック多層基板の製造方法。

【請求項3】 カード位置決め孔をセラミックグリーンシートに形成してからセラミックグリーンカードとして裁断し、そのセラミックグリーンカードをカード位置決め孔に挿入される支軸で揃えて複数枚をカセット台に積層載置するようにしたことを特徴とする請求項1または2のセラミック多層基板の製造方法。

【請求項4】 セラミックグリーンカードを異なる形態 毎に個別のカセット台に積層載置し、そのセラミックグ リーンカードを個別のカセット台から次工程で多層接合 される順に取り出すと共に、多層接合順に編集させて複 30 数枚を一つのカセット台に積層載置するようにしたこと を特徴とする請求項1または2のセラミック多層基板の 製造方法。

【請求項5】 スルーホール加工,電極印刷,電極乾燥,多層接合工程を含む各工程を経て、セラミックグリーンシートからセラミック多層基板を製造するのに用いられるセラミック多層基板の製造装置において、セラミックグリーンシートから所定な大きさのカード状に裁断されたセラミックグリーンカードを一枚づつ受け取るカード受取り手段と、そのセラミックグリーンカードを該40カード受取り手段で順次に受け取って複数枚積層載置するカセット台と、複数枚のセラミックグリーンシートが積層載置されたカセット台から一枚づつ次工程に転送するカード取出し手段とをカセット台からカセット台で連続させてセラミックグリーンカードの受取り、取出し転送手段として組み付けてなることを特徴とするセラミック多層基板の製造装置。

【請求項6】 セラミックグリーンカードのカード面に 設けられたカード位置決め孔に挿通する支軸で、セラミ ックグリーンカードを複数枚揃えて積層載置するカセッ 50 ト台を備えてなることを特徴とする請求項5のセラミック多層基板の製造装置。

【請求項7】 セラミックグリーンカードを異なる態様 毎に夫々個別に積層載置する複数台のカセット台と、そ のセラミックグリーンカードを各カセット台から次工程 で多層積層される順に取出し編集させて複数枚積層載置 する一つのカセット台とをカード編集手段として装備し てなることを特徴とする請求項5のセラミック多層基板 の製造装置。

【請求項8】 セラミックグリーンカードをベースフィルム付きのままベースフィルム側から圧接加熱するセラミックグリーンカードの加熱用定盤と、その加熱用定盤で加熱処理されたセラミックグリーンカードをベースフィルムから剥離させて複数枚接合保持する積層ヘッドをカード多層接合手段として装備してなる請求項5のセラミック多層基板の製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、スルーホール加工,電 20 極印刷,電極乾燥,多層接合工程を含む各工程を経て、 セラミックグリーンシートからセラミック多層基板を製 造するのに適用されるセラミック多層基板の製造方法及 び装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、積層磁器コンデンサ等を製造する場合を例示すると、誘電材粉末、バインダー、可塑剤、有機溶剤等を成分とするセラミックスラリーをポリエチレンテレフタレート等でなるベースフィルムのフィルム面に塗布することによりセラミックグリーンシートを得、このセラミックグリーンシートをスルーホール加工、電極印刷、電極乾燥等の各工程にベースフィルムで連続送りさせて所定の加工処理を施した後、そのセラミックグリーンシートからベースフィルムを剥離し、複数枚多層接合することにより多層セラミックシートとして形成することが提案されている(特開昭63-188926号)。

【0003】このベースフィルムによる連続送りを適用すると、セラミックグリーンシートをベースフィルムで担持することにより送れるからセラミックグリーンシートを変形させないで確実に多層接合することができる。然し、そのシート処理ではセラミックグリーンシートを変形させないで確実に多層接合することができる。然し、そのシート処理ではセラミックグリーンシートを中ではセラミックグリーンシートを設備に対し、再度ロール巻きすることを繰返してわなければならない。また、この製造工程中工程によってはロールを設備に掛け換え或いは工程処理後にロールを巻き戻す作業も必要であって掛け換えに要する時間と手間が掛りしかも工程的に極めて煩雑で機械的にも大型なものになる。それに加えて、例えば電極の印刷工程中で印刷のニジミやカスレ等の如きトラブルが発生すると、この原因が解消されるまで次工程の印刷電極乾燥工程を停止しなければならない。また、その間にセラミッ

3

クグリーンシートを炉内に停滞させたままにすると、ベースフィルムが熱変形してしまう等の不具合もある。

【0004】このシート処理による欠点を除去するにはセラミックグリーンシートをカード状に裁断し、セラミックグリーンカードとしてスルーホール加工、電極印刷,電極乾燥、多層接合工程を含む各工程に送り込めばよい。そのカード処理によると、スルーホール加工やスルーホールによる電極間接合、多層接合等をカードー枚一枚単位に高精度に行えるところから好ましい。この反面、セラミックグリーンカードを一枚一枚取り扱うこと 10になるから、セラミックグリーンカードを合理的に転送処理することにより少なくとも製造リードタイムの短縮化等を図る必要がある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、セラミックグリーンシートをカード状に裁断することによりセラミックグリーンカードとして一枚一枚取り扱い、それによる製品歩留りの向上は勿論、異種な製品の製造にも容易に対応できて品種切換えの段取時間や製造リードタイムの短縮化も図れることにより設備稼働率を向上でき、ま20た、設備の小型化も図れるセラミック多層基板の製造方法及び装置を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1に係るセラミック多層基板の製造方法においては、セラミックグリーンカグリーンシートを所定な大きさのセラミックグリーンカードに裁断し、そのセラミックグリーンカードを力セット台に順次に積層載置し、次工程にはセラミックグリーンカードを複数枚積層載置されたカセット台から順次に取出し転送し、全工程をカセット台からカセット台で連 30 続させてセラミックグリーンカードを転送送りするようにされている。

【0007】本発明の請求項2に係るセラミック多層基板の製造方法においては、樹脂フィルムをベースフィルムとして形成されたセラミックグリーンシートからベースフィルム付きのままセラミックグリーンカードを裁断し、以後の工程をベースフィルム付きのまま転送処理し、多層接合時にベースフィルムをセラミックグリーンカードから剥離するようにされている。

【0008】本発明の請求項3に係るセラミック多層基 40 板の製造方法においては、カード位置決め孔をセラミックグリーンシートに形成してからセラミックグリーンカードとして裁断し、そのセラミックグリーンカードをカード位置決め孔に挿入される支軸で揃えて複数枚をカセット台に積層載置するようにされている。

【0009】本発明の請求項4に係るセラミック多層基板の製造方法においては、セラミックグリーンカードを異なる形態毎に個別のカセット台に積層載置し、そのセラミックグリーンカードを個別のカセット台から次工程で多層接合される順に取り出すと共に、多層接合順に編 50

集させて複数枚を一つのカセット台に積層載置するよう にされている。

【0010】本発明の請求項5に係るセラミック多層基板の製造装置においては、セラミックグリーンシートから所定な大きさのカード状に裁断されたセラミックグリーンカードを一枚づつ受け取るカード受取り手段と、そのセラミックグリーンカードを該カード受取り手段で順次に受け取って複数枚積層載置するカセット台と、複数枚のセラミックグリーンシートが積層載置されたカセット台から一枚づつ次工程に転送するカード取出し手段とをカセット台からカセット台で連続させてセラミックグリーンカードの受取り、取出し転送手段として組み付けることにより構成されている。

【0011】本発明の請求項6に係るセラミック多層基板の製造装置においては、セラミックグリーンカードをカード面に設けられたカード位置決め孔に挿通する支軸でセラミックグリーンカードを複数枚揃えて積層載置するカセット台を備えることにより構成されている。

【0012】本発明の請求項7に係るセラミック多層基板の製造装置においては、セラミックグリーンカードを異なる態様毎に夫々個別に積層載置する複数台のカセット台と、そのセラミックグリーンカードを各カセット台から次工程で多層接合される順に取出し編集させて複数枚積層載置する一つのカセット台とをカード編集手段として装備することにより構成されている。

【0013】本発明の請求項8に係るセラミック多層基板の製造装置においては、セラミックグリーンカードをベースフィルム付きのままベースフィルム側から圧接加熱するセラミックグリーンカードの加熱用定盤と、その加熱用定盤で加熱処理されたセラミックグリーンカードをベースフィルムから剥離させて複数枚接合保持する積層へッドとをカード多層接合手段として装備することにより構成されている。

[0014]

【作用】本発明の請求項1に係るセラミック多層基板の製造方法では、セラミックグリーンシートをカード状に裁断し、そのセラミックグリーンカードの一枚一枚に対してスルーホール加工,電極印刷,多層接合等の加工処理を順次個別に施すところから、各加工処理時にセラミックグリーンカードを高精度に容易に位置合せできて製品歩留りの向上を図ることができる。また、セラミックグリーンカードの一枚を個別に取り扱うことにより出ても、加工処理後はカセット台に順次に積層載置し、次工程には複数枚積層載置されたカセット台から一枚で傾次に送り出すことから、セラミックグリーンカードの積層載置乃至は送り出しを迅速に行えることにより製造リードタイムを短縮でき、品種切換えも容易に行えることにより表記を記載を記述されてきる。

【0015】本発明の請求項2に係るセラミック多層基

30

板の製造方法では、セラミックグリーンカードをベース フィルム付きのまま多層接合まで加工処理し、また、カ セット台からカセット台に積層載置、取り出しするた め、セラミックグリーンカードの一枚一枚を容易に取り 扱い得て皺や捩れ等による変形が生ずるのも防止するこ とができる。

【0016】本発明の請求項3に係るセラミック多層基 板の製造方法では、セラミックグリーンカードをカード 位置決め孔に挿入される支軸で揃えてカセット台に積層 載置することから、セラミックグリーンカードをカセッ 10 ト台に整然と積層載置できて一枚一枚の取り出しも容易 に行うことができる。

【0017】本発明の請求項4に係るセラミック多層基 板の製造方法では、セラミックグリーンカードを多層接 合する前に、その多層接合順に編集させてカセット台に 予め積層載置するから、態様の異なるセラミックグリー ンカードを多層接合するのも迅速に行える。

【0018】本発明の請求項5に係るセラミック多層基 板の製造装置では、セラミックグリーンシートから所定 の大きさに裁断されたセラミックグリーンカードを各工 20 程における加工処理後カード受取り手段でカセット台に 順次積層載置し、また、複数枚積層載置されたカセット 台からカード取出し手段で次工程に順次送り込むもの で、セラミックグリーンカードとして円滑に受け取り乃 至は取り出せることから製造リードタイムを短縮できし かも装置全体として小型なものに構成することができ る。それに加えて、異品種のものでも一様に適用できる ところから製品の品種範囲を拡大でき、また、その品種 切換えも容易に行えることにより設備稼働率も向上する ことができる。

【0019】本発明の請求項6に係るセラミック多層基 板の製造装置では、カセット台としてセラミックグリー ンカードを支軸で揃えて複数枚積層載置するものを備え るから、セラミックグリーンカードを複数枚整列と積層 載置できて取出しも容易に行うことができる。 ·

【0020】本発明の請求項7に係るセラミック多層基 板の製造装置では、態様の異なるセラミックグリーンカ ードを多層接合順に編集させて積層載置するカード編集 手段を備えるから、態様の異なるセラミックグリーンカ ードを多層接合するのも迅速に行える。また、態様の異 40 なるセラミックグリーンカードを個別に積層載置する複 数のカセット台と、そのカセット台から取り出されるセ・ ラミックグリーンカードを積層順に載置する一つのカセ ット台とをカード編集手段とすることから機構的にも簡 単なものに構成することができる。

【0021】本発明の請求項8に係るセラミック多層基 板の製造装置では、セラミックグリーンカードを多層接 合するとき、セラミックグリーンカードをベースフィル ム側から加熱用定盤で加熱することによりセラミックグ リーンカードからベースフィルムを剥離し、それと同時 50

にセラミックグリーンカードを積層ヘッドで複数枚接合 保持するものであるから、簡単な機構で能率よく多層接 合処理することができる。

[0022]

【実施例】以下、添付図面を参照して説明すれば、図1 で示すセラミック多層基板の製造装置は最終製品として 製造される電子部品の品種に応じて選択される磁性材ま たは誘電材のセラミック粉末、バインダー、可塑剤、有 機溶剤等を混合したセラミックスラリーを用い、これを シート状に形成したセラミックグリーンシートからセラ ミック多層基板を製造するのに適用されている。セラミ ックグリーンシートSはポリエチレンテレフタレートフ ィルム等をベースフィルムとして帯状に連続させて形成 され、それをロール状に巻回させて装備することにより 装置内に繰出し供給できるよう備えられる。このセラミ ックグリーンシートSはベースフィルムのフィルム面に 形成することから、10μm以下の薄膜状に或いは積層 厚みで1.5mm以上になる厚膜状にも形成することが できる。また、ロール状に巻回するのにあたってはセラ ミックグリーン層を保護することからベースフィルムを 外層側に位置させて巻回するとよい。

【0023】そのセラミックグリーンカードSは、図2 で示すように所定な大きさのセラミックグリーンカード Cに裁断して各工程に供給される。また、このセラミッ クグリーンカードCはセラミックグリーン層1を坦持す るベースフィルム2を付けたままでカード状に裁断し、 後述する如く各工程に連続送りする途上で皺や捩れ等の 変形が生ずるのを防ぐようにされている。そのセラミッ クグリーンカードCは、図3で示すようにカセット台に 積層載置する際のカード位置決め孔3a, 3b…と、所 定の加工処理をカード面に施す際の画像位置決め基準孔 4 a, 4 b …とをセラミックグリーンシートSの段階で シート面に設けてから所定の大きさのカード状にに裁断 形成するようにされている。

【0024】このセラミックグリーンカードCからセラ ミック多層基板を製造する装置としては、セラミックグ リーンシートの繰出し機10,カード位置決め孔加工機 20, カード裁断機30, スルーホール加工機40, 電 極印刷機50,印刷電極の乾燥機60,カード編集機7 0,カード多層接合機80,多層セラミックグリーンカ ードのスタッカ台90を順次に配列することにより構成 されている。また、カード裁断機30とスルーホール加 工機40との間、スルーホール加工機40と電極印刷機 50との間、印刷電極乾燥機60とカード編集機70と の間並びにカード編集機70とカード多層接合機80と の間には複数枚のセラミックグリーンカードを積層載置 するカセット台100,110,120,130が夫々 配置されている。

【0025】これらカセット台100,110,12 0,130としてはスルーホール加工機40と電極印刷 機50との間に配設するもので説明すると、図4で示す如く上述したカード位置決め孔3a,3b…(図3参照)に挿入することによりセラミックグリーンカードCを複数枚揃えて積層保持する支軸110a,110b…をテーブル面に立付け装備したものが備え付けられている。その支軸110a,110b…は、カード位置決め孔がセラミックグリーンカードCの複数個所に分けて設けられているときは各孔に整合位置させて同数本を立付け装備するとよい。また、このカセット台110にはセラミックグリーンカードを前工程から受け取って積層載10置するものと、複数枚積層載置されたセラミックグリーンカードを次工程に取出し転送するものとを一個所に併置することによるダブルカセットオートチェンジャー機

【0026】そのカセット台110を中心に、セラミックグリーンカードを前工程から受け取って複数枚積層載置するカード受取り手段112と、複数枚積層載置されたセラミックグリーンカードCを一枚づつ次工程に転送送りするカード取出し手段113とを備えることにより、一つのカード転送手段として装備されている。これ20らカード受取り手段112,カード取出し手段113は、十,一エアーによる真空吸着ヘッドや可撓部材による吸着パッドで構成することができる。そのカード転送手段によっては、全工程をカセット台からカセット台で連続させてセラミックグリーンカードを受取り、取出し転送するものとして装置全体が構成されている。

構を採用するとよい。

【0027】セラミックグリーンシートの繰出し機10は、図5で示すようにロール状に巻回されたセラミックグリーンシートSをリール11で装架し、ベースフィルム側を上向きに位置させて繰出し送りするガイドローラ 3012,13…を備えて構成されている。

【0028】このセラミックグリーンシートの繰出し機 10に引続いて、カード位置決め孔加工機20とカード 裁断機30とが順に配設されている。カード位置決め孔 加工機20は、セラミックグリーンシートSの受け台2 1と、図3で示すカード位置決め孔3a, 3b…と画像 位置決め基準孔 4 a , 4 b …とを同時成形する各刃型 2 2a, 22b…、23a, 23b…を備えて昇降動可能 な金型24とを具備する。カード裁断機30は上下に相 対位置させて昇降動可能に装備された一対の切断刃31 でなり、その切断刃31の作動時にセラミックグリーン シートSを上下から挾持する一対のシート固定用爪32 をカード位置決め加工機20寄りに備えると共に、セラ ミックグリーンシートSの先端側を上下から挾持するこ とによりシート固定用爪32からセラミックグリーンカ ードとして裁断される長さに応じて水平方向にストロー ク動する一対のシート送り用爪33を備えて構成されて

【0029】この工程では、セラミックグリーンシート Sを所定長さ繰り出させて先端側をシート固定用爪32 50 8

寄りに近接動したシート送り用爪33で挟持し、まず、カード位置決め孔並びに画像位置決め基準孔を金型24でシート面に形成する。その後、シート送り用爪33を一定距離水平方向にストローク動させてセラミックグリーンシートSを一枚のセラミックグリーンカード分だけ引き出す。このシート送り用爪33のストローク動が終了すると、シート固定用爪32並びに切断刃31を作動させてセラミックグリーンシートSを一枚のセラミックグリーンカードCとして裁断し、シート送り用爪33から解放させてカセット台100に載置する。

【0030】カセット台100においては、セラミックグリーンカードCを下部側から吸着保持するカード受取り手段101を装備し、このカード受取り手段101がセラミックグリーンカードCを受け取って反転することによりベースフィルムを下向きに向けてカセット台100に載置する。この間、シート送り用爪33が上述した動作を繰返し行ってセラミックグリーンカードを切断刃31で順次に裁断し、それをカード受取り手段101で受け取って複数枚をカセット台100に積層載置することができる。

【0031】そのカード裁断機30に引続いて、図6で示すスルーホール加工機40が配設されている。このスルーホール加工機40は、後述する如く印刷形成される電極を内部電極として他と接続するべく導電材料が装填されるスルーホールをカード面に設けるのに配設されている。そのスルーホール加工機40はYAGレーザ照射機またはパンチングマシン等の孔開け機41と、セラミックグリーンカードCが前工程のカセット台100から一枚づつ取出し載置されるXY&テーブル42とを備えている。

【0032】 X Y θテーブル42は、水平方向前後乃至は左右に移動し或いは縦軸を中心としてテーブル面を必要角回転することによりテーブル面上に載置されたセラミックグリーンカードの位置ズレ修正を行うものとして装備されている。また、この X Y θ テーブル42は前工程のカセット台100寄りから孔開け機41の直下位置まで水平にシリンダでストローク動可能に配設され、そのテーブル面にはカセット台100のセラミックグリーンカードを真空吸着ヘッド等によるカード取出し手段102(矢印で示す)で取出し転送するよう構成されている。

【0033】この $XY\theta$ テーブル42のテーブル面上には、各セラミックグリーンカードの画像位置決め基準孔を撮像カメラ43で捉えて画像処理し、 $XY\theta$ テーブル42を制御することによりスルーホールの孔開け位置を調整する画像処理手段が備え付けられている。また、その $XY\theta$ テーブル42にはスルーホールの孔開け処理されたセラミックグリーンカードをテーブル面から移し換えて次工程に送る補助テーブル44が付設されている。この $XY\theta$ テーブル42からは、スルーホールの孔開け

加工されたセラミックグリーンカードを補助テーブル4 4に移し換え、上述したカセット台110のカード受取 り手段111(矢印で示す)で受取り保持することによ りカセット台110に複数枚積層載置される。

【0034】スルーホール加工機40に引続いて、図7 で示す電極印刷機50と印刷電極乾燥機60とが順に配 設されている。電極印刷機50は、所定なパターンの電 極をセラミックグリーンカードのカード面に形成するス クリーン印刷機51と、そのセラミックグリーンシート を前工程のカセット台110からカード取出し手段11 2 (矢印で示す) で取り出すことにより 裁置する X Y θ テーブル52とを備えている。XYθテーブル52はス ルーホール加工機40のΧΥθテーブル42と同様に動 作し、撮像カメラ53によるセラミックグリーンカード の位置決め用画像処理手段と、電極が印刷されたセラミ ックグリーンカードをテーブル面から移し換える補助テ ーブル54とを備えて構成されている。

【0035】印刷電極の乾燥機60は複数枚の循環移動 する棚板61a, 61b…を内部に備えた乾燥炉でな り、セラミックグリーンカードのカード面に印刷形成さ 20 れた電極を乾燥処理するものとして装備されている。こ の印刷電極の乾燥機60と電極印刷機50との間には、 電極印刷されたセラミックグリーンカードを複数枚の棚 板61a,61b…に順次載置することで電極印刷機5 0とのカード送りタイミングを十分に取れるからカセッ ト台を配設する必要がない。唯、図3で示すと同様なカ セット台を予備的に配置してもよい。その印刷電極の乾 燥処理後は、印刷電極の乾燥処理されたセラミックグリ ーンカードを棚板61a,61b…からカード受取り手 段121 (矢印で示す) で受け取ってカセット台120 に複数枚積層載置することができる。

【0036】印刷電極乾燥機60に引続いて、図8で示 **すカード編集機70が配設されている。このカード編集** 機70は、一つのセラミック多層基板を形成するのに印 刷パターンの異なる電極が形成されたセラミックグリー ンカードを要するとき、印刷パターンから態様の異なる セラミックグリーンカード毎に複数枚積層載置し、その 態様の異なるセラミックグリーンカードを次工程で行う 多層接合順に編集させて積層載置するものとして装備さ れている。

【0037】この編集を行うべく、カード編集機70は 態様の異なるセラミックグリーンカード毎に積層載置す る複数のカセット台71,72,73…と、その複数の カセット台71、72、73…から態様の異なるセラミ ックグリーンカードを多層積層順に積載する一つのカセ ット台130とを備えて構成されている。また、このカ ード編集機70には前工程のカセット台120からセラ ミックグリーンカードを各態様毎に受け取ってカセット 台71,72,73…に積層載置すると共に、各カセッ ト台 7 1, 7 2, 7 3 …からセラミックグリーンカード 50 ーンカードから剝離するベースフィルムを盤面上から廃

を多層接合順に受け取ってカセット台130に順次積層 載置するXYθ多軸移動ロボット等のカード取出し手段 131(矢印で示す)が備え付けられている。カセット

台130としては、カード取出し手段131で態様の異 なるセラミックグリーンカードを迅速に多層積層順に積 層し、また、取り出せるようダブルオートチェンジャー

10

カセット (130a, 130b) を備え付けるとよい。 【0038】そのカード編集機70の次には、図9で示 すカード多層接合機80が配設されている。そのカード 多層接合機80は、前工程のカセット台130からセラ ミックグリーンカードをカード取出し手段132(矢印 で示す)で取り出すことによりベースフィルム側からテ ーブル面に載置される載置テーブル81と、この載置テ ーブル81のテーブル面に載置されたセラミックグリー ンカードのカード面を所定面積に区画する切れ目5を入 れる昇降動可能なカッター82と、切れ目5の入れられ たセラミックグリーンカードをグリーンシート側から受 取り保持する昇降動可能な積層ヘッド83と、その積層 ヘッド83が受取り保持したセラミックグリーンカード をベースフィルム側から盤面に圧接させて加熱する加熱 用定盤84とを備えて構成されている。

【0039】 載置テーブル81としては、テーブル面上 に載置されたセラミックグリーンカードを位置ズレ修正 するべく、上述したと同様な水平方向前後乃至は左右に 移動し或いは縦軸を中心としてテーブル面を必要角回転 可能なΧΥθテーブルを装備することができる。そのテ ーブル面上の所定位置には、撮像カメラ85を備えてセ ラミックグリーンカードの位置ズレ量を画像処理で測定 し、この位置ズレ量に応じて載置テーブル81を駆動制 30 御するよう画像処理手段が装備されている。

【〇〇4〇】このセラミックグリーンカードの載置テー ブル81に対し、カッター82は所定位置で昇降動する よう装備されている。そのカッター82はセラミックグ リーンカードを載置テーブル81のテーブル面上で位置 ズレ修正した後下降動し、四辺形の切れ目5をセラミッ クグリーンカードのカード面に入れることによりセラミ ックグリーンカードのカード面を所定面積に区画する刃 型86を備えている。

【0041】積層ヘッド83は、上述したカード受取 り、取出し手段と同様なセラミックグリーンカードをグ リーンシート側から吸着保持し、また、所定層数積層接 合した後エアーを吹き出すことにより積層セラミックグ リーンカードを吸着面から離す+, -エアーによる真空 吸着ヘッド或いは可撓部材による吸着パッド等を備えて 構成することができる。この積層ヘッド83は、セラミ ックグリーンカードの載置テーブル81と加熱用定盤8 4との間を往復動すると共に、夫々の所定位置で昇降動 するよう装備されている。加熱用定盤84はヒーター等 を内蔵した平金型でなり、後述する如くセラミックグリ

棄するチャック等の摘出手段を備えて構成することができる。

【0042】このカード多層接合機80では、ベースフィルム付きのセラミックグリーンカードがカセット130からカード取出し手段132(矢印で示す)で一枚づつ載置テーブル81のテーブル面上に送り込まれる毎にセラミックグリーンカードが送り込まれる毎にセラミックグリーンカードの位置ズレを撮像カメラ85による画像処理で測定し、このズレ量に応じて載置テーブル81をXYの方向に移動させて位置ズレ修正を行う。そ10の位置ズレ修正終了後、載置テーブル81はテーブル面を所定位置に保ったままカッター82の昇降動位置下にまで移動する。

【0043】 載置テーブル81がカッター82の昇降動 位置下に移動すると、カッター82が載置テーブル81 のテーブル面上に載置されたセラミックグリーンカード のカード面に向けて下降動し、位置ズレ修正されたセラ ミックグリーンカードのカード面を所定面積に区画する 切れ目5をセラミックグリーンカードに入れる。その切 れ目5の付設後はカッター82は直ちに上昇動し、載置 20 テーブル81は切れ目5の入れられたセラミックグリー ンカードを所定位置に保って積層ヘッド83が移動する まで待機する。この載置テーブル81からは、積層ヘッ ド83が下降動することにより、セラミックグリーンカ ードをグリーンシート側から吸着保持する。そのセラミ ックグリーンカードの吸着時には積層ヘッド83が所定 位置で下降動することから、セラミックグリーンカード は位置ズレ修正された正規な位置を保って積層ヘッド8 3 で受取り保持される。

【0044】積層ヘッド83はセラミックグリーンカー 30 ドをグリーンシート側から吸着保持すると直ちに上昇動 し、加熱用定盤84の配設位置上に復帰動することによ り加熱用定盤84に向けて下降動する。その積層ヘッド 83の下降動に伴って、セラミックグリーンカードはベ ースフィルム側から加熱用定盤84に圧接されて加熱処 理される。このセラミックグリーンカードがベースフィ ルム側から加熱されると、セラミックグリーンカードの バインダーが軟化し、ベースフィルムがグリーンカード 側から剥れる状態になる。その加熱処理後に積層ヘッド 83が上昇動するのに伴って、切れ目5で区画された所 40 定面積のセラミックグリーンカードが積層ヘッド83で 吸着保持されたままでベースフィルムから剥し取られ る。また、ベースフィルムはセラミックグリーンカード から剥離されて加熱用定盤84の盤面上に残る。この残 存するベースフィルムは、次に積層ヘッド83が復帰動 するまでの間に加熱用定盤84の盤面上から取り除かれ て廃棄処分される。

【0045】積層ヘッド83は所定面積のセラミックグ リーンカードを吸着保持したまま、次の位置ズレ修正さ れて切れ目5の付けられたベースフィルム付きのセラミ 50 12

ックグリーンカードが待機する載置テーブル81に向けて移動する。その積層ヘッド83が載置テーブル81に向けて下降動すると、積層ヘッド83で吸着保持されたセラミックグリーンカードのバインダーが軟化状態に保たれていることから、次のセラミックグリーンカードはセラミックグリーン層相互がバインダーで仮付けされてベースフィルムの付いたまま積層ヘッド83で受取り保持される。

【0046】積層ヘッド83は次のセラミックグリーンカードを受取り保持すると加熱用定盤84の配置位置に復帰動し、次のセラミックグリーンカードを加熱用定盤84の盤面に圧接するよう下降動する。その下降動に伴っては、次のセラミックグリーンカードも加熱用定盤84で加熱処理されてバインダーの軟化によるベースフィルムの剥離が行われると共に、先のセラミックグリーンカードとセラミックグリーン層相互で加熱圧締させて多層接合できるようになる。

【0047】ここまでの繰返しで、ベースフィルムの付いたままで用いられるセラミックグリーンカードは複数枚多層接合されて多層セラミックグリーンカードとして形成することができる。その多層セラミックグリーンカードは、積層ヘッド83からスタッカ台90に転送したセラことにより部品単位の切断、焼成後の事後処理を行うべく後工程に供給することができる。なお、上述したセラミックグリーンカードの加熱圧締は加熱温度60℃、圧力40kg/cm²、時間2~4秒程度で行える。また、セラミックグリーンカードを載置テーブル81から積層ヘッド83で受け取るよう説明したが、載置テーブル81から加熱用定盤84に別のカード取出し手段で移し換えて積層ヘッド83で多層接合するようにもできる

【0048】このセラミック多層基板の製造装置では、セラミックグリーンシートをカード状に裁断して一枚一枚取り扱うことから、スルーホールを形成しまたは電極を印刷形成し、更には多層接合する時でも画像処理による位置決め手段を適用でき、セラミックグリーンカードを一枚一枚正確に位置決めするよう処理することができる。また、セラミックグリーンカードをベースフィルム付きの多層接合工程まで取り扱うから各工程処理中に皺や振れ等の変形が生ずるのも防げ、総じて製品歩留りの向上を図ることができる。

【0049】そのセラミックグリーンカードを一枚一枚取り扱うとしても、所定の加工処理後カセット台に順次に積層載置し、次工程には複数枚積層載置されたカセット台から順次に取出し転送するように全工程をカセット台からカセット台で連続させてセラミックグリーンカードを転送送りすることから製造リードタイムを短縮できる。また、カセット台としてはセラミックグリーンカードをカード位置決め孔に挿入される支軸で揃えて複数枚積層載置するものを備えるから、セラミックグリーンカ

ードを整然と積層載置し、また、取出し転送できることによりセラミックグリーンカードを一枚一枚能率よく取り扱うことができる。これに加えて、全工程をカセット台に積層載置し、取出し転送することによりカード処理することから品種の異なるものの製造にも適用できて品種換えを容易に行え、セラミック多層基板の製造装置として極めて効率よく設備稼働させることができる。

【0050】また、態様の異なるセラミックグリーンカードを多層接合するときでも、セラミックグリーンカードを多層積層順に予め編集させてカセット台に載置する 10 工程を含むことから極めて能率よく多層接合処理することができる。その多層接合に際してもセラミックグリーンカードを加熱用定盤で加熱処理することによりバインダーを軟化させてカード相互を接合し、これと同時にセラミックグリーンカードからベースフィルムを剥離するものであるからセラミックグリーンカードを効率よく多層接合することができる。

【0051】このセラミック多層基板の製造方法及び装置は積層磁器コンデンサ等の誘電体部品に限らず、磁性体部品を製造するのにも適用できる。特に、低温焼成可 20能なアルミナ多層基板からVCO, BPF, DPX等の高周波対応部品を製造するのに適し、また、多品種少量生産に対応するのに適している。

[0052]

【発明の効果】以上の如く、本発明に係るセラミック多層基板の製造方法及び装置に依れば、セラミックグリーンカードを一枚一枚正確に取り扱えることから製品歩留りの向上を図れ、全工程をカセット台からカセット台で連続させてセラミックグリーンカードを転送送りすることで製造リードタイムを短縮することもできる。また、異品種の製造にも容易に対応できて設備稼働率を向上できると共に、設備全体としても小型なものに構成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るセラミック多層基板の製造装置を 全体的に示す説明図である。 : *【図2】同装置において取り扱うセラミックグリーンカードを示す側面図である。

【図3】同セラミックグリーンカードを示す平面図である。

【図4】図1の装置に装備されるカセット台の説明図である。

【図5】図1の装置に装備されるセラミックグリーンシートの繰出し機並びにカード裁断機を示す説明図である。

0 【図6】図1の装置に装備されるスルーホール加工機を 示す説明図である。

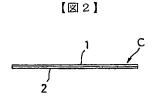
【図7】図1の装置に装備される電極印刷機並びに電極 乾燥機を示す説明図である。

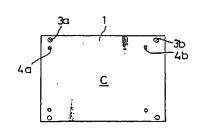
【図8】図1の装置に装備されるカード編集機を示す説明図である。

【図9】図1の装置に装備されるカード多層接合機を示す説明図である。

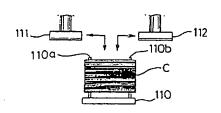
【符号の説明】

S	セラミックグリ
ーンシート	
С	セラミックグリ
ーンカード	
2	ベースフィルム
3 a , 3 b …	カード位置決め
孔	
7 0	カード編集手段
71, 72, 73…	カード編集用カ
セット台	
100, 110, 120, 130	カード積層載置
用カセット台	
110a, 110b…	カセット台の支
軸 .	
101, 111, 121, 131	カード受取り手
段	
102, 112, 122, 132	カード取出し手
段	



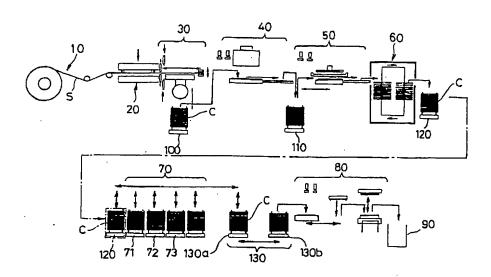


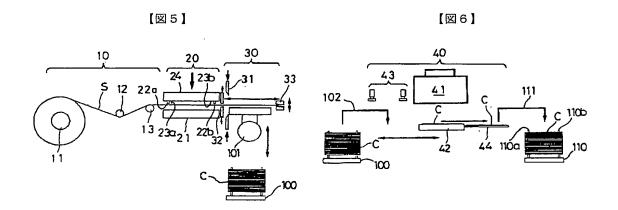
【図3】

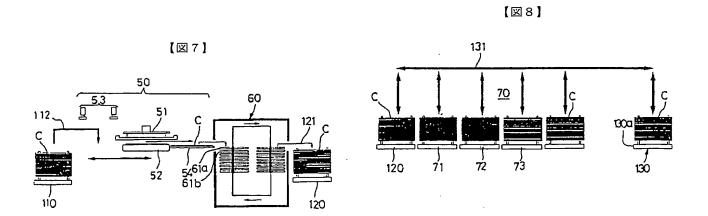


[図4]

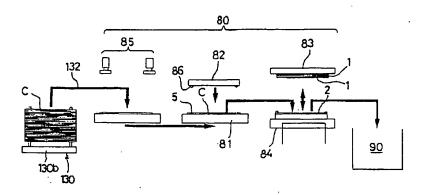
【図1】







【図9】



フロントページの続き

(72)発明者 須藤 純一

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

(72)発明者 佐々木 智之

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内